

The Capabilities of IC Substrate PCB

| 项目 | | 工艺能力 | | |
|------|------|-------|---|----------|
| | | 量产 | 样品 | |
| 材料 | 板材 | 板材类型 | BT类材料, 常见品牌: (MGC / Doosan / LG /AMC) | ← |
| | | 芯板厚度 | 35 , 40, 50, 60, 100, 130, 150, 200, 250, 300, 450um | ← |
| | 基铜厚度 | 外层基铜 | 2, 3, 5, 9, 12, 18um | ← |
| | | 内层基铜 | 2, 3, 5, 9, 12, 18, 35, 70um | ← |
| | PP | PP类型 | 与板材同品牌 | ← |
| | | PP厚度 | 18um ~ 110um | 15um |
| | 油墨 | 液态油墨 | AUS308 , AUS320 , EG23 | + AUS703 |
| | | 干膜油墨 | AUS410, SR1, SR3 | ← |
| | 树脂油墨 | 树脂油墨 | PHP-900 IR-6PH , PHP-900 IR-10FE, PHP-900 IR-6P | ← |
| 表面处理 | OSP | OSP药水 | Tamura : F2(LX)-PK Shikoku : WPF-207 | ← |
| | | 类型 | Soft Au, OSP, ENIG, ENEPIG, AFOP(S-OSP), Hard Au | ← |
| | 表面处理 | 厚度 | Soft Au: Ni : 2~15um / Au : 0.3~1.0um ENIG: Ni : 3~10um / Au : 0.03~0.1um ENEPIG: Ni: 3~10um / Pd: Min 0.05um / Au: 0.05~0.1um OSP: 0.15~0.45um | ← |

The Capabilities of IC Substrate PCB

| 项目 | 工艺能力 | |
|-----------|-------------|---|
| | 量产 | 样品 |
| 板子结构 | 层数 | ~ 8L (2+4+2) |
| | 最小芯板厚度 | 0.035mm |
| | 最小PP厚度 | 0.018mm |
| | 外层最小铜厚 | 10um |
| | 成品板厚 | 0.090mm(2L) / 0.140mm(4L)/ 0.215mm(6L)/0.280mm(8L) |
| | 成品板厚公差 | ±0.015mm(2L), ±0.025mm (4L), ±0.04mm (6L~) |
| | 单PCS尺寸 | 1.2x1.2mm |
| | 生产板尺寸 | 510×415mm |
| | 层间结构 | Full stack via (w/ Cu via filling), VOP, VIP, Via on PTH |
| 绑定手指/线路能力 | 外层最小线宽/间距 | 25/25um(Tenting) 15/15um(MSAP) 13/13um(ETS) |
| | 外层最小线宽/间距公差 | ±30% (if L/S=25~30/25~30, ±40%) |
| | 绑定手指最小pitch | 65um |
| | 绑定手指顶部最小宽度 | 35um |
| | 绑定手指最小间距 | 15um |

The Capabilities of IC Substrate PCB

| 项目 | | 工艺能力 | |
|------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 量产 | 样品 |
| 阻焊能力 | 最小阻焊厚度 | 15um | 15um |
| | 阻焊厚度公差 | ±5um | ±3um |
| | 最小绑定手指阻焊开窗环 | 50um | 35um |
| | 最小阻焊开窗尺寸 | 60um | 50um |
| | 最小阻焊对准度 | ±20um | ±15um |
| | 最小阻焊桥 | 80 (Green) 120 (Black) | 70 (Green) 100 (Black) |
| | 最小阻焊盖线距离 | 50um | 35um |
| 过孔能力 | 最小机械钻孔尺寸 | 100um | ← |
| | 最小机械钻孔的线路pad尺寸 | 200um | 180um |
| | 最小激光孔尺寸 | 55um | 50um |
| | 最小BVH激光孔的线路pad尺寸 | 125um | 110um |
| 尺寸公差 | 定位孔到Strip板边公差 | ±75um | ±50um |
| | Strip长宽尺寸公差 | ±100um | ±75um |
| | 最小铣槽宽度 | 0.7mm | 0.6mm |

The Capabilities of IC Substrate PCB

| 项目 | 工艺能力 | |
|-------|-------------|------------------------------|
| | 量产 | 样品 |
| 电镀能力 | 通孔最大厚径比 | 4:1 |
| | VIP激光孔最大厚径比 | 1.875:1 |
| | VIP激光孔尺寸 | 60-100um |
| | BVH激光孔最大厚径比 | 1:1 |
| | BVH激光孔尺寸 | 50-120um |
| | 填孔最大Dimple | 10um |
| 层间对准度 | 相邻层间对准度 | ±35um |
| | 任意层间对准度 | ±50um |
| 其他 | 阻抗公差 | ±10% |
| | 翘曲度 | 1% 0.5% |
| | 特殊流程 | TLP(Busless), E/B(Etch Back) |